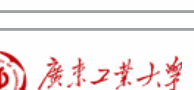


论坛日程
Forum Agenda

8月26日，星期三 Wednesday, 26 August				
上午	14A36峰会区	14H36论坛区	14H20论坛区	16A60论坛区
		展商论坛 碳化硅主题论坛 WBG_SiC 主持人： 陈立烽先生，英飞凌科技（中国）有限公司 Infineon Technologies	合作会议 GaN for Physical AI 主持人： 杨宇博士，Yole Group	合作会议 云网车芯，聚变未来 Computing Power、Electric Vehicle、WBG Semiconductors
下午	峰会 全球战略峰会 Global Strategy Summit 主持人： 刘进军教授，西安交通大学 Xi'an Jiaotong University	展商论坛 碳化硅的应用主题论坛 Applications of SiC 主持人： 韩金刚教授，上海海事大学 Shanghai Maritime University	展商论坛 氮化镓主题论坛 WBG_GaN 主持人： 章进法博士，台达电子企业管理(上海)有限公司 Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd.	展商论坛 封装与测试主题论坛（一） Packaging and Testing I 主持人： 陈铂先生，莱姆电子中国有限公司 LEM Electronics (China) Co., Ltd.
8月27日，星期四 Thursday, 27 August				
上午	14A36峰会区	14H36论坛区	14H20论坛区	16A60论坛区
	峰会 功率半导体新锐峰会 Power Semiconductor Rising Stars Summit 主持人： 张波教授，电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China	展商论坛 交通电气化主题论坛 E-mobility 支持单位： 中国电源学会交通电气化专业委员会 主持人： 康劲松教授，同济大学 Tongji University	展商论坛 IGBT主题论坛 IGBT 主持人： 宋高升先生， 三菱电机机电（上海）有限公司 Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd.	合作会议 超宽禁带半导体前沿 技术论坛 Ultra-wide Semiconductor 主持人： 左正博士，深圳平湖实验室 Shenzhen Pinghu Laboratory
下午		展商论坛 电力电子技术主题论坛 Power Electronics 主持人： 宋文胜教授，西南交通大学 Southwest Jiaotong University	展商论坛 AI电源应用主题论坛 AI Power Supply Applications 主持人： 陈烨楠教授，浙江大学 Zhejiang University	展商论坛 固态断路器主题论坛 Solid State Circuit Breaker (SSCB) 主持人： 陈子颖先生
8月28日，星期五 Friday, 28 August				
上午	14A36峰会区	14H36论坛区	14H20论坛区	16A60论坛区
	展商论坛 电力电子化电力系统 主题论坛 Power Electronics Dominated Power System 主持人： 孙耀杰教授，复旦大学 Fudan University	展商论坛 智能驱动与控制主题论坛 Intelligent Drive and Control 主持人： 汤天浩教授，上海海事大学 Shanghai Maritime University		合作会议 封装与测试主题论坛（二） Packaging and Testing II 主持人： 叶怀宇教授，南方科技大学 Southern University of Science and Technology

PCIM Asia Shenzhen 2026 拟定演讲单位 Speakers

 MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better	 Infineon 英飞凌	 SEMIKRON DANFOSS	 富士电机 Fuji Electric	 ROHM	 BOSCH	 EPC EFFICIENT POWER CONVERSION SEMI-CONDUCTORS	 power Integrations	 VISHAY The DNA of tech.	 TEXAS INSTRUMENTS
 nexperia	 TOSHIBA	 Innoscence 英诺赛科	 中国中车 CRRC	 ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR	 SwissSEM	 华润微电子 CR MICRO	 宏微 科技 MACMIC	 青铜创技术 Bronze Technologies	 基本半导体 BASIC Semiconductor
 FATON Powering Business Worldwide	 INOVANCE	 Firstack 飞仕得科技	 钢泰公司 INDIUM CORPORATION	 MacDermid Alpha ELECTRONICS SOLUTIONS	 Heraeus	 INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS	 东微半导体 ORIENTAL SEMI	 ALKAIDSEMI INNOVATION AND EXCELLENCE	 威兆半导体 verigiga semiconductor
 三井金属	 ROGERS CORPORATION	 OLsemi 清连科技	 ZESTRON	 NOVOSENSE	 DYNAN	 RAYTRONS	 Alpha power solutions	 昕感科技 N E X T C	 LOFOTEN 龙腾半导体股份有限公司 Lonten Semiconductor Co., Ltd.
 CLASM CaiLun Advanced	 Rime-rel 锐米科技	 YITONG Yi-Tong	 ASC 益粤能 AscenPower	 AJM	 晟驰微电子 SEMICON CHAMPION	 DXE 氮铂科技	 GaNnext	 TRUMPF	 芯迈半导体 CINT
 YOLE Group	 英飞源技术 INFY POWER	 inspur 浪潮	 山东科鑫技术有限公司 Shandong Kexin Technology Co., Ltd.	 中国联通 China Unicom	 HUAWEI	 富加镓业 FUJICA GALLIUM	 CRYSDIAM	 GARENSEMI 绿仁半导体	
 ELPE	 深圳平湖实验室 SHENZHEN PINGHU LABORATORY	 清华大学 Tsinghua University	 中国科学院大学 University of Chinese Academy of Sciences	 中国科学院电工研究所 Institute of Electronics Engineering, Chinese Academy of Sciences	 西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY	 香港大学 THE UNIVERSITY OF HONG KONG	 西安电子科技大学 XIDIAN UNIVERSITY	 上海交通大学 SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY	 浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY
 合肥工业大学 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	 广东工业大学 GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY								

*排名不分先后 Not in specific order

*以上为拟定议程，PCIM Asia Shenzhen 2026保留解释权和议程变更的权利

论坛日程
Forum Agenda

8月26日， 星期三上午		Wednesday A.M., 26 August	
14H20论坛区		14H36论坛区	
GaN for Physical AI 合作会议 主持人：杨宇博士， Yole Group		碳化硅 展商论坛 WBG_SiC 主持人：陈立烽先生， 英飞凌科技（中国）有限公司 Infineon Technologies	
09:30-9:35 Welcome & Opening Remarks Yu Yang， Yole Group， Principal Lead Analyst, Automotives & Robotics		10:00-10:20 英飞凌CoolSiC™ Easy modules助力更高电压与功率密度需求 张明丹， 英飞凌科技（中国）有限公司， 工业与基础设施业务大中华区产品总监 Infineon Technologies	
09:35-9:55 Physical AI: Market Overview & Key Trends Yu Yang， Yole Group， Principal Lead Analyst, Automotives & Robotics		10:20-10:40 中高压SiC模块为大容量电力电子注入“碳”基动力 孙建， 三菱电机机电（上海）有限公司， 高级经理 Mitsubishi Electric & Electronics (SHANGHAI) CO., LTD.	
09:55-10:15 Advanced Semiconductor Solutions for Smart Mobility 纳芯微电子 Kathleen GAO， NOVOSENSE， Head of Smart Power Stage		10:40-11:00 Bosch SiC: Serving Local Automotive Customers with Performance, Quality, and Reliability Bruno Schuster， 博世（中国）投资有限公司， Vice President Automotive Power Semiconductors Asia-Pacific Bosch (China) Investment Ltd.	
10:15-10:35 GaN Devices in Automotive Power Supplies: Applications and Outlook Yunpeng Yao， 汇川技术， Power Supply Architect INOVANCE		11:00-11:20 Powering the Future: Cutting-Edge Si & SiC for AI and Electrification Lars Knoll， SwissSEM Technologies AG， GM&CTO	
10:50-11:10 Powering the Future of Humanoid Robotics Leading Humanoid OEM		11:20-11:40 中车嵌入式封装助力新一代功率半导体系统升级 李贵生， 株洲中车时代半导体有限公司， SiC FAE高级经理 ZHUZHOU CRRC TIMES SEMICONDUCTOR CO., LTD	
11:10-11:30 From Silicon to GaN: How TI is Redefining the Future of Humanoid Robotics Chen Gao， 德州仪器， System Engineer TEXAS INSTRUMENTS		16A60论坛区	
11:30-11:50 We power Humanoid Robot Winter Cheng， 英飞凌科技（中国）有限公司, GaN Champion Infineon Technologies		云网车芯， 聚变未来 合作会议 Computing Power、Electric Vehicle、WBG Semiconductors	
11:50-12:05 Embedded GaN power modules for industrial drones Huang Mingxin， 香港大学， Chair Professor THE UNIVERSITY OF HONG KONG		10:00-10:25 筑牢算力通信底座， 赋能AI时代新征程 杨程， 中国联通， 战略总监 China United Network Communications	
12:05-12:25 GaN Market & Technology Update Xiran ZUO, Yole Group， Market & Technology Analyst, Power Electronics		10:25-10:50 硅基世界的源知 张晟彬， 浪潮集团， 战略总监 Inspur Group	
12:25-12:30 Closing Remark Yu Yang， Yole Group， Principal Lead Analyst, Automotives & Robotics		10:50-11:15 TBD 沈斌， 深圳市至信微电子有限公司， 销售总监 Jiangsu Semicon Champion Microelectronics Co., Ltd.	
		11:40-12:05 GaN器件赋能12kW PSU：高效率、高功率密度的实现路径 张大江， 珠海镓未来科技有限公司， IP与技术合作总监 GaNext (zhuhai) Technology Co.,Ltd	
		11:15-11:40 半导体功率器件的全域保护 田伟华， 江苏晟驰微电子有限公司， 产品技术总监 Jiangsu Semicon Champion Microelectronics Co., Ltd.	

论坛日程
Forum Agenda

8月26日，星期三，下午		Wednesday P.M., 26 August	
14A36峰会区		14H20论坛区	
全球战略峰会 Global Strategy Summit 主持人：刘进军教授，西安交通大学 Xi'an Jiaotong University		氮化镓 WBG_GaN 主持人：章进法博士，台达电子企业管理(上海)有限公司 Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd.	
13:30-13:35 主持人开场致词 刘进军，西安交通大学，教授 Xi'an Jiaotong University		13:30-13:50 英领创新 GaN有效率 程文涛，英飞凌科技（中国）有限公司，消费、计算与通讯业务大中华区市场总监 Infineon Technologies	
13:35-14:05 Global Development Trend of Semiconductor devices Leo Lorenz，欧洲电力电子中心，研讨会顾问主席 European Center for Power Electronics (ECPE)		13:50-14:10 氮化镓的未来展望 Dr. Alex Lidow，宜普电源转换公司，CEO Efficient Power Conversion (EPC)	
14:05-14:35 从电网到终端的能效革命：英飞凌功率半导体赋能电力全价值链 陈立烽，英飞凌科技（中国）有限公司，副总裁，工业与基础设施业务大中华区技术负责人 Infineon Technologies		14:10-14:30 GaN在AI数据中心供电系统中的应用 时春州，江苏宏微科技股份有限公司，高级研发工程师 MACMIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	
14:35-15:05 通过功率半导体创新，助力家电、电动出行、新能源及电力传输实现低碳未来 宋高升，三菱电机机电（上海）有限公司，首席技术顾问 Mitsubishi Electric & Electronics (SHANGHAI) Co., Ltd.		14:30-14:50 迈向MHz，氮化镓开启AI电源新时代 林逸铭，英诺赛科（苏州）科技股份有限公司，产品线高级经理 Innoscience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.	
15:05-15:35 国产化替代趋势下的产品规划与产能布局 李国斌，芯联集成电路制造股份有限公司，工控及服务器电源营销副总经理 United Nova Technology Co., Ltd.		14:50-15:10 新一代蓝宝石基氮化镓功率半导体技术 李祥东，西安电子科技大学，教授 Xidian University	
15:35-16:05 未来能源互联网络的半导体化演进趋势及挑战 刘云峰，华为技术有限公司，数字能源首席科学家 Huawei Technologies Co., Ltd.			
16:05-16:35 AIDC供电架构的演进及固态变压器发展 郑大为，伊顿，伊顿电气亚太区电能质量研发副总裁 Eaton Corporation			
16:35-17:05 全球功率半导体市场数据拆解及产业战略研判 杨宇，Yole Group，Principal Lead Analyst, Automotives & Robotics			
17:05-17:10 开放互动，共解行业关键议题			
14H36论坛区		16A60论坛区	
碳化硅的应用 Applications of SiC 主持人：韩金刚教授，上海海事大学 Shanghai Maritime University		封装与测试（一） Packaging and Testing I 主持人：陈铂先生，莱姆电子中国有限公司 LEM Electronics (China) Co., Ltd.	
13:30-13:50 罗姆碳化硅车载解决方案 王字宇，罗姆半导体（上海）有限公司，ATE ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.		13:30-13:50 突破功率密度与可靠性瓶颈：下一代电力电子封装材料创新实践 胡彦杰，钢泰公司，中国区技术经理 Indium Corporation	
13:50-14:10 SiC DIPIPM——家电减碳新引擎 王小岭，三菱电机机电（上海）有限公司，高级经理 Mitsubishi Electric & Electronics (SHANGHAI) CO., LTD.		13:50-14:10 麦德美爱法应用于功率半导体的烧结及焊接解决方案进展 赵宇，麦德美爱法，高级业务发展经理 MacDermid Alpha	
14:10-14:30 大型AIDC配电系统大功率变流器技术方案研究 欧阳泽涛，赛米控丹佛斯电子（南京）有限公司，应用工程师 Semikron Danfoss Electronics (Nanjing) Co., Ltd.		14:10-14:30 银领未来，焊接新境--面向多元应用的互连材料创新 董侃，上海贺利氏工业技术材料有限公司，电子功率市场总监 Heraeus Materials Technology Shanghai Ltd.	
14:30-14:50 工业级全碳化硅模块和大容量HPnC模块介绍 周征宇，富士电机（中国）有限公司，资深高级经理 Fuji Electric (China) Co., Ltd.		14:30-14:50 采用中车 IGBT 芯片的 MiniSKiiP 产品介绍 叶剑鋢，赛米控丹佛斯电子（南京）有限公司，电气工程师 Semikron Danfoss Electronics (Zhuhai) Co., Ltd.	
14:50-15:10 博世碳化硅，赋能数据中心和固态变压器黄金时代 王骏跃，博世（中国）投资有限公司，资深高级经理 Bosch (China) Investment Ltd.		14:50-15:10 New Trends in Interconnection for Power Module Cetier Jonathan，欧纷泰化工(上海)有限公司，Global Account and Business Development Director INVENTEC Performance Chemicals	
15:10-15:30 依托Power Integrations专用门极驱动器产品组合，提升SiC MOSFET模块的效率与可靠性 王皓，Power Integrations, 大功率系统工程经理		15:10-15:30 纳米金属烧结技术创新助力功率器件降本增效 贾强，北京清连科技有限公司，董事长 Beijing QLsemi Technology Co.,Ltd.	
15:30-15:50 AOS SiC: 为AI服务器电源提供高效能，高功率密度解决方案 朱礼斯，Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS)，应用工程经理		15:30-15:50 Bonding Properties and Reliability Evaluation of Cu Sinter Paste for Heatsink Attach Zhang Zheng，三井金属贸易（上海）有限公司，Senior Rep. Mitsui Kinzoku Trading (Shanghai) Co., Ltd.	
15:50-16:10 高压SiC器件技术的最新进展与应用演进 余伟，株洲中车时代半导体有限公司，研发中心副主任 ZHUZHOU CRRC TIMES SEMICONDUCTOR CO., LTD		15:50-16:10 SST/轻量化电驱用铝散热器高可靠散热铜烧结解决方案 王晓，蔡伦先进半导体材料（重庆）有限责任公司，总经理 CLASM	
16:10-16:30 碳化硅驱动应用解析 熊凯，深圳青铜剑技术，驱动产品线总监 Bronze Technologies Ltd.		16:10-16:30 无功负载试验——一种基于应用工况的应力筛选测试方法 余超群，山东阅芯电子科技有限公司，CMO Prime-Rel Electronic Technology Ltd. Co.	

论坛日程

Forum Agenda

8月27日，星期四上午		Thursday A.M., 27 August	
14A36峰会区		14H20论坛区	
功率半导体新锐峰会 Power Semiconductor Rising Stars Summit 主持人：张波教授， 电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China		IGBT 展商论坛 主持人：宋高升先生， 三菱电机机电（上海）有限公司 Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd.	
10:00-10:20 TBD 张波， 电子科技大学， 教授 University of Electronic Science and Technology of China		10:00-10:20 面向光储应用的第8代IGBT模块 胡博， 三菱电机机电（上海）有限公司， 应用技术经理 Mitsubishi Electric & Electronics (SHANGHAI) CO., LTD.	
10:20-10:40 氮化镓驱动在激光雷达发射端的落地应用与产业价值 刘家才， 成都氮矽科技有限公司， 副总经理 ZHUJI DAN XI TECHNOLOGY CO.,LTD		10:20-10:40 中车逆导IGBT技术及产品解决方案 曾宏， 株洲中车时代半导体有限公司， FAE负责人 ZHUZHOU CRRC TIMES SEMICONDUCTOR CO., LTD	
10:40-11:00 面向算力中心供电的8英寸15V-1200V功率GaN研究进展 David Zhou， 深圳平湖实验室， GaN首席科学家 Shenzhen Pinghu Laboratory		10:40-11:00 第七代 CAL 软恢复二极管：释放新一代 IGBT 极限性能演讲概要 朱凤杰， 赛米控丹佛斯电子（南京）有限公司， 中国应用团队负责人 Semikron Danfoss Electronics (Nanjing) Co., Ltd.	
11:00-11:20 AIDC电源全栈解决方案 王毅， 苏州东微半导体， IC技术部总监 Suzhou Oriental Semiconductor Co., Ltd		11:00-11:20 安世新一代IGBT模块介绍----重新定义极端环境下的耐用性标准 张姗姗， 安世半导体中国， 产品市场经理 Nexperia China	
11:20-11:40 面向功率器件的铜烧结工艺：嵌入式芯片封装与压接 IGBT 封装方案 张志愿， 深圳市先进连接科技有限公司， 技术总监 Shenzhen Advanced Joining Technology Co. , Ltd		11:20-11:40 TBD 通快（中国）有限公司 TRUMPF China Co., Ltd.	
11:40-12:00 结合塑封与灌封技术优势的新型D2M功率模块 邱建， 翼同博海科技（珠海横琴）有限公司， 研发副总 CN-iCuTech.,Ltd			
14H36论坛区		16A60论坛区	
交通电气化 E-Mobility 主持人：康劲松教授， 同济大学 Tongji University 支持单位：中国电源学会交通电气化专业委员会		超宽禁带半导体前沿技术论坛 合作会议 主持人：左正博士， 深圳平湖实验室 Shenzhen Pinghu Laboratory	
10:00-10:20 下一代新能源汽车电控系统发展方向分析 耿旭旭， 英飞凌科技（中国）有限公司， 汽车业务大中华区专家工程师 Infineon Technologies		10:05-10:30 超宽禁带半导体的挑战和进展 张道华， 深圳平湖实验室， 新加坡工程院院士， 第四代半导体首席科学家 Shenzhen Pinghu Laboratory	
10:20-10:40 硅·碳·未来——车载功率芯势力 Zhiqing Yang， 三菱电机机电（上海）有限公司， 技术经理 Mitsubishi Electric & Electronics (SHANGHAI) CO., LTD.		10:30-10:55 金刚石半导体材料和器件的进展 张金凤， 西安电子科技大学， 教授 Xidian University	
10:40-11:00 富士电机车规级功率半导体产品介绍 刘振泽， 富士电机（中国）有限公司， FAE Fuji Electric (China) Co., Ltd.		10:55-11:20 高质量大尺寸氧化镓衬底晶圆的进展与挑战 张辉， 杭州镓仁半导体， 董事长 Hangzhou GAREN Semiconductor Co., Ltd.	
11:00-11:20 先进碳化硅 MOSFET 赋能电力电子设计提速革新 韩少韦， 威世（中国）投资有限公司， FAE Vishay		11:20-11:45 大尺寸高质量氧化镓单晶衬底及外延片产业化进展 齐红基， 杭州富佳镓业， 董事长 Hangzhou Fujia Gallium Technology Co., Ltd.	
11:20-11:40 curamik® DirectCool——突破 SiC 功率密度极限的一体化液冷解决方案 Tobias Holz， 罗杰斯科技（苏州）有限公司， 市场开发经理 Rogers Technology (Suzhou) Co., Ltd.		11:45-12:00 AIN单晶PVT生长及其射频/功率/光电器件进展 吴亮， 奥趋光电， CEO Ultratrend Technologies (Hangzhou) Co., Ltd.	
11:40-12:00 驾驭高压电子潮湿鲁棒性——失效机理及预防 王克同， 洁创贸易（上海）有限公司， 北亚区R&S经理 Zestron Trading (Shanghai) Co., Ltd		12:00-12:25 功能性金刚石材料的产业化应用与前沿探索 张军安， 宁波晶钻科技， 董事长 Ningbo Crysdiam Industrial Technology Co., Ltd.	

论坛日程

Forum Agenda

8月27日，星期四下午		Thursday P.M., 27 August	
14A36峰会区		14H20论坛区	
功率半导体新锐峰会 Power Semiconductor Rising Stars Summit 主持人：张波教授，电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China		AI电源应用 AI Power Supply Applications 主持人：陈烨楠教授，浙江大学 Zhejiang University	
13:30-13:50 SiC场控晶体管技术及产品 陈喜明，飞镭半导体有限公司，研发VP Alpha Power Solutions		13:30-13:50 英飞凌 从电网到核心全链路电源解决方案 卢柱强，英飞凌科技（中国）有限公司，消费、计算与通讯业务大中华区市场总监 Infineon Technologies AG	
13:50-14:10 嵌埋SiC器件量产的痛点分析与解决方案 黄明欣，大乙半导体科技有限公司，创始人 Dynano Semiconductor Technology Co., Ltd		13:50-14:10 AI 服务器电源基础应用及产品推广 何绍松，罗姆半导体（上海）有限公司，ATE ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	
14:10-14:30 TBD 龙腾半导体股份有限公司		14:10-14:30 威世创新元器件：赋能下一代 AI 服务器 许诚恩，威世，产品应用工程师 Vishay	
14:30-14:50 TBD 芯粤能		14:30-14:50 800V数据中心辅源解决方案: 超薄、高效 Jason Yan, Power Integrations, 首席技术培训师	
14:50-15:10 TBD		14:50-15:10 全栈赋能，智算未来：华润微AI数据中心一站式解决方案 吴泉清，华润微电子有限公司，高级总监 China Resources Microelectronics Limited (CRM)	
15:10-15:30 TBD		15:10-15:30 算力电源之东芝功率芯片 李松涛，东芝电子元件（上海）有限公司，高级工程师 Toshiba Devices & Storage (Shanghai) Co., Ltd.	
15:30-15:50 TBD		15:30-15:50 中低压MOSFET在AI数据中心电源的应用 高子健，芯迈半导体，系统应用主管 Silicon-Magic Semiconductor Technology (Hangzhou) Co., Ltd.	
15:50-16:10 TBD		15:50-16:10 SiC技术在智算中心电源系统的应用 沈军武，基本半导体，产品经理 BASiC Semiconductor Co., Ltd.	
14H36论坛区		16A60论坛区	
电力电子技术 Power Electronics 主持人：宋文胜教授，西南交通大学 Southwest Jiaotong University		固态断路器 Solid State Circuit Breaker (SSCB) 主持人：陈子颖先生	
13:50-14:10 SEMITRANS 20 封装三电平 TNPC 拓扑，适用于低压变频器 景巍，赛米控丹佛斯电子（南京）有限公司，产品开发总监 Semikron Danfoss Electronics (Nanjing) Co., Ltd.		13:30-13:50 固态断路器关键技术研究、装备研制及多场景应用 屈鲁，清华大学，副研究员 Tsinghua University	
14:10-14:30 器件与系统：威兆高性能功率半导体应用与演进 田峰，深圳市威兆半导体股份有限公司，高级系统应用工程师 Shenzhen Vergiga Semiconductor Co., Ltd		13:50-14:10 固态式断路器全流程开发与工程实践 李伟，山东泰开直流技术有限公司 Taikai Group Co.LTD	
14:30-14:50 TBD 瑶芯微（上海）电子科技股份有限公司 Alkaidsemi (Shanghai) Technologies Corporation		14:10-14:30 CoolSiC™JFET：固态配电的核心动力 鲍秀平，英飞凌科技（中国）有限公司，工业与基础设施业务大中华区高级市场经理 Infineon Technologies	
14:50-15:10 TBD		14:30-14:50 算力基础设施保护新范式-Polaris SSCB在AIDC直流配电系统的应用 王煜晨，伊顿（中国）投资有限公司，固态断路器产品经理 Eaton Corporation	
15:10-15:30 Passivity-Based Stabilization of LCL-Filtered Grid-Following Inverters Hyeon-Sik Kim，嘉泉大学，Associate Professor Gachon University		14:50-15:10 提高IGBT驱动电压实现超低静态损耗 陈哲，杭州飞仕得科技有限公司，技术市场总监 Hangzhou Firstack Technology Co., Ltd.	
15:30-15:50 Power Decoupling Control of Virtual Admittance-based Grid-Forming Inverters via Complex Vector Analysis Joon-Hee Lee，蔚山科学技术院，Assistant Professor Ulsan National Institute of Science and Technology, Korea		15:10-15:30 双向混合固态断路器专用IGBT器件研究 荣睿，江苏宏微科技股份有限公司，市场总监 MACMIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	
15:50-16:10 Robust Stabilization Control of Grid-Tied Converters Considering Voltage and Frequency Support 杨之青，合肥工业大学，副教授 Hefei University of Technology		15:30-15:50 PCB 嵌入式 封装在 eFUSE 双向开关中的应用设计 彭裔天，丰鹏电子（珠海）有限公司，应用工程总监 Raytrons Limited	
		15:50-16:10 分立式碳化硅器件用于固态断路器内阻断MOV路径的过流能力分析 周雯琪，博世（中国）投资有限公司，功率电子技术专家 Bosch (China) Investment Ltd.	

论坛日程

Forum Agenda

8月28日， 星期五上午		Friday A.M., 28 August	
14A36峰会区		14H36论坛区	
电力电子化电力系统 展商论坛 Power Electronics Dominated Power System 主持人：孙耀杰教授， 复旦大学 Fudan University		智能驱动与控制 展商论坛 Intelligent Drive and Control 主持人：汤天浩教授， 上海海事大学 Shanghai Maritime University	
10:00-10:20 TBD 复旦大学 Fudan University		10:00-10:20 国家新能源汽车专项电驱动方向进展与成果 温旭辉， 中国科学院电工研究所， 研究所主任 Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences	
10:20-10:40 AI赋能直流微网创新发展 董玥宏， 深圳英飞源技术有限公司， 高级产品经理 INFYPOWER		10:20-10:40 精准驱动， 智能赋能 —— EG12x 实时可调电流型栅极驱动芯片 金鑫， 博世（中国）投资有限公司， 高级应用工程师 Bosch (China) Investment Ltd.	
10:40-11:00 TBD 为恒智能科技股份有限公司		10:40-11:00 新型串联绕组电机控制器及智能控制方法 蒋栋， 华中科技大学， 教授 Huazhong University of Science and Technology	
11:00-11:20 TBD 金盘科技		11:00-11:20 工业智能体驱动的高柔性具身智能装备与系统研发与应用实践 杨之乐， 中国科学院大学， 中国科学院深圳先进技术研究院研究员 University of Chinese Academy of Sciences	
11:20-11:40 TBD 北京昕感科技（集团）有限责任公司		11:20-11:40	
16A60论坛区			
封装与测试（二） 合作会议 Packaging and Testing II 主持人：叶怀宇教授， 南方科技大学 Southern University of Science and Technology			
10:00-10:30 第三代半导体功率器件先进封装：从纳米银烧结到全铜互连的跨越 叶怀宇， 南方科技大学， 副教授 Southern University of Science and Technology			
10:30-11:00 碳化硅MOSFET高温驱动技术：隔离封装挑战与CMOS集成进展 陈中， 香港理工大学， 副教授 The Hong Kong Polytechnic University			
11:00-11:30 GaN功率器件可靠性评价关键技术 贺致远， 广东工业大学， 教授 Guangdong University of Technology			
11:30-12:00 IEC 60749-34-1:2025功率循环可靠性测试新标准：关键变化、宽禁带器件 张毅， 香港理工大学， 助理教授 The Hong Kong Polytechnic University			



扫描二维码

免费报名听会

Scan the QR code to register for free



微信扫描关注

“PCIM电力电子新世代”公众号

Follow us on our official wechat account

同期会议分布图

